



# SoundBonding application



## 〈リチウムイオン電池 電極の接合〉

更に進化した**MSB**で **LIB 積層箔 100 枚以上の複数ヶ所同時接合**

### 【クリップ合金接合 /Clip-Ingot Bonding】

CIBのツールの先端形状は丸みを帯びておりエネルギーを集中できます。これまでのメッシュツールによる接合とは異なり、**傷が付かない**ホットキスで綴じた様な、**コンタミが発生しない**ソフトタッチの〈綺麗〉な接合方法です。

### 【進化したMST /Multi-Step Tool】

MSTでは丸みを帯びた先端形状が多段に重なりエネルギーがより先端部に集中し、スムーズに接合することができます。その結果**接合時間を短縮でき、積層箔へのダメージをより軽減し、接合音が小さくなり、接合強度が更に増し**ます。(Patent)



【アルミ積層箔とアルミプレートの2カ所同時接合】



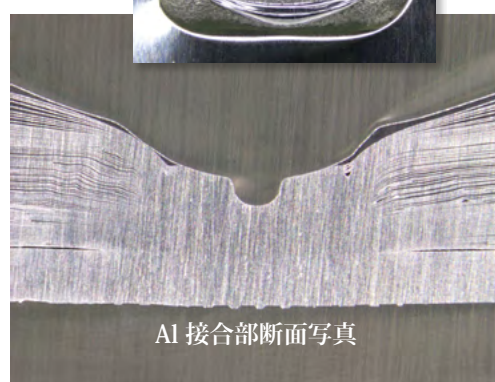
【銅積層箔と銅プレートの2カ所同時接合】



【接合部拡大】

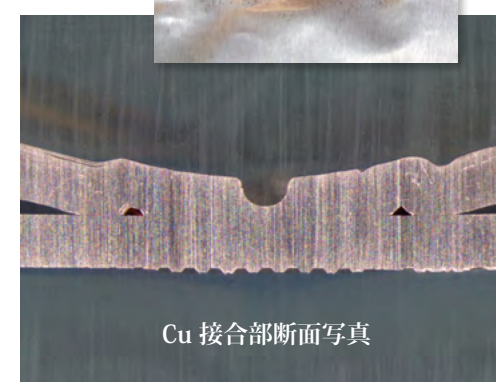


【接合部拡大】



Al 接合部断面写真

【アルミ箔 t=15 μm x 100枚] 保護シート無し



Cu 接合部断面写真

【銅箔 t=8 μm x 100枚] 保護シート無し

